HESS XD-200MC

Установка волновой пайки для компонентов с длинными выводами



HESS XD-200MC — компактная установка волновой пайки для печатных плат шириной 50–200 мм с выводными компонентами, в том числе с длинными выводами. Машина работает с бессвинцовыми и традиционными припоями. Цикл включает флюсование, независимый преднагрев и пайку волной припоя.

В число основных особенностей входят одна независимая зона преднагрева длиной 400 мм и мощностью 3,5 кВт, одна волна припоя с регулировкой высоты в диапазоне 0–20 мм, паяльная ванна ёмкостью около 180 кг, управление температурой PID/SSR, ПЛК собственной разработки и сенсорный экран.

Телефон: 8 812 220-44-88
Эл. почта: mail@gkhs.ru

Область применения

- Пайка компонентов, в том числе с длинными выводами, на платах шириной 50–200 мм.
- Работа с бессвинцовыми и традиционными припоями.
- Использование в линиях сборки электронных узлов.

Транспортная система и обслуживание

Стабильная износостойкая транспортная система использует запатентованные цепные захваты из сплава, устойчивые к деформации. Угол наклона направляющих регулируется от 0 до 3°; предусмотрены подъём и выдвижение паяльной ванны.

Автоматическое флюсование

Распылитель с шаговым электродвигателем обеспечивает равномерное нанесение флюса. Расход — 10–100 мл/мин; вместимость резервуара — до 5,2 л.

Независимый предварительный нагрев

Независимая зона преднагрева длиной 400 мм имеет мощность 3,5 кВт. В каталоге указаны горячий воздух и инфракрасный нагрев. Температура настраивается от комнатной до 250 °C.

Паяльная система

В стандартном исполнении предусмотрена одна волна припоя с регулировкой высоты 0–20 мм. Конструкция сопла обеспечивает стабильную волну и снижает окисление припоя. Ванна примерно на 180 кг оснащена нагревом 6 кВт и управлением PID/SSR.

Принцип работы

1. Плата поступает на конвейер и проходит нанесение флюса.
2. Независимая зона преднагрева подготавливает плату к пайке.
3. Волна припоя обеспечивает пайку выводов компонентов.

Технологические узлы



Сенсорная панель управления



Входной участок конвейера



Внутреннее устройство

Технические характеристики

Общие параметры	
Модель	XD-200MC
Тип оборудования	Установка волновой пайки
Габариты (Д × Ш × В)	2150 × 1100 × 1450 мм
Размеры рамы (Д × Ш × В)	1450 × 1050 × 1400 мм
Масса	Около 400 кг
Пусковая (общая) мощность	До 10 кВт
Рабочая мощность	Около 2 кВт
Система управления	ПЛК собственной разработки
Интерфейс управления	Сенсорный экран
Электропитание	380 В, трёхфазная пятипроводная сеть
Давление подачи воздуха	4–7 кгс/см²
Запатентованные конструкции	4 (по данным производителя)

Система распыления флюса	
Вместимость резервуара флюса	До 5,2 л
Расход флюса	10–100 мл/мин
Привод распылителя	Шаговый электродвигатель

Система предварительного нагрева	
Способ нагрева	Горячий воздух / инфракрасный нагрев
Количество зон	1
Длина участка предварительного нагрева	400 мм
Мощность предварительного нагрева	3,5 кВт
Температура предварительного нагрева	От комнатной до 250 °C
Управление преднагревом	Независимое

Опции и варианты исполнения

Опция / вариант исполнения	
Способ предварительного нагрева	Горячий воздух / инфракрасный нагрев
Транспортировка справа налево	Адаптация к расположению оборудования в линии
Количество волн	Изменение конфигурации паяльной системы — по заказу

Транспортная система	
Ширина печатной платы	50–200 мм
Высота транспортировки	750 ± 20 мм
Скорость транспортировки	0–1800 мм/мин
Угол наклона направляющих	0–3°
Направление транспортировки	Слева направо; справа налево — опция
Высота компонентов над платой	До 100 мм
Цепные захваты	Запатентованный сплав; устойчивость к деформации
Транспортная система	Стабильная и износостойкая

Паяльная система	
Применяемые припои	Бессвинцовые и традиционные
Количество волн	1 (конфигурация по заказу)
Регулировка высоты волны	0–20 мм
Мощность нагрева паяльной ванны	6 кВт
Температура паяльной ванны	От комнатной до 300 °C
Управление температурой	PID + твердотельное реле SSR
Вместимость паяльной ванны	Около 180 кг припоя
Перемещение паяльной ванны	Подъём и выдвижение
Конструкция сопла	Обеспечивает стабильную волну и снижает окисление